

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月10日(10.08.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/149434 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/24 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08G 18/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/003092

(22) 国際出願日: 2023年1月31日(31.01.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-015063 2022年2月2日(02.02.2022) JP

(71) 出願人:株式会社クラレ(KURARAY CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津1 6
2 1 番地 Okayama (JP).

(72) 発明者: 砂山 梓 紗 (SUNAYAMA Azusa);
〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7 4 7 1
番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 合
志 佑有子 (GOSHI Yuko); 〒1000004 東京都
千代田区大手町2 - 6 - 4 株式会社クラ
レ内 Tokyo (JP). 加藤 充 (KATO Mitsuru);
〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7 4 7 1 番
地 株式会社クラレ内 Okayama (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI
PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎

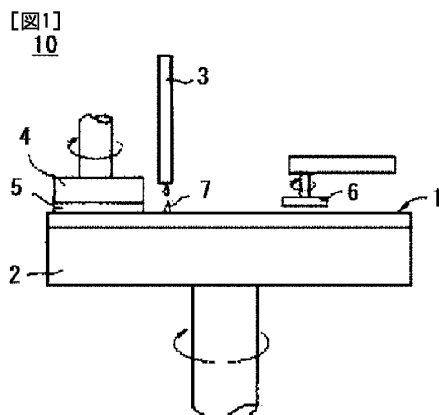
ノ門三丁目2 5 番2 号 虎ノ門E S
ビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

(54) Title: POLISHING LAYER, POLISHING PAD, METHOD FOR MANUFACTURING POLISHING PAD, AND
POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨層、研磨パッド、研磨パッドの製造方法及び研磨方法



(57) Abstract: A polishing layer containing polyurethane, the elongation at break of the polyurethane at a tension speed of 50mm/min after undergoing 50 ° C water-based saturation swelling being less than 100%; a polishing pad comprising said polishing layer and a method for manufacturing the polishing pad; and a polishing method using the polishing pad.

(57) 要約: ポリウレタンを含む研磨層であり、前記ポリウレタンの、50℃の水で飽和膨潤させた後の引張速度50mm/minにおける破断伸度が、100%未満である、研磨層、該研磨層を備える研磨パッド及びその製造方法、並びに該研磨パッドを用いる研磨方法に関する。

[続葉有]

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）